

产品说明书

倒装片助焊剂 NC-826

特点

- 用于铜柱倒装片蘸取应用
- 粘附性足以在组装时把晶粒保持在基片上
- 与其它底部填充材料兼容
- 不会沾在晶粒表面上
- 蘸取时较少桥连
- 无气泡真空包装
- 残留物少
- 不含卤素
- 免洗

简介

倒装片助焊剂NC-826是一种不含卤素的免洗助焊剂，用于倒装片浸渍涂布，它的残留物是透明的，完全无害。由于减少了残留物，底部填充的粘附性能得到优化，并且减少了底部填充在固化时可能出现的气体逸出。

特性

特性	测试结果	测试方法
助焊剂类型	RELO	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 和 2.3.33)
颜色	淡黄色	目视观察
粘度 (典型值)	13kcps	Brookfield DV-I. 51CPE 5分钟后以20rpm的转速旋转
酸度 (典型值)	39mg KOH/g	滴定法
表面绝缘电阻 (欧姆)	合格	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
焊后残留物重量	<10%	TGA 数据
工作寿命	≥ 8 小时	用户提供 (浸渍)
保质期	6 个月 (0℃ 至 30℃ 储存)	粘度变化/显微镜下检查

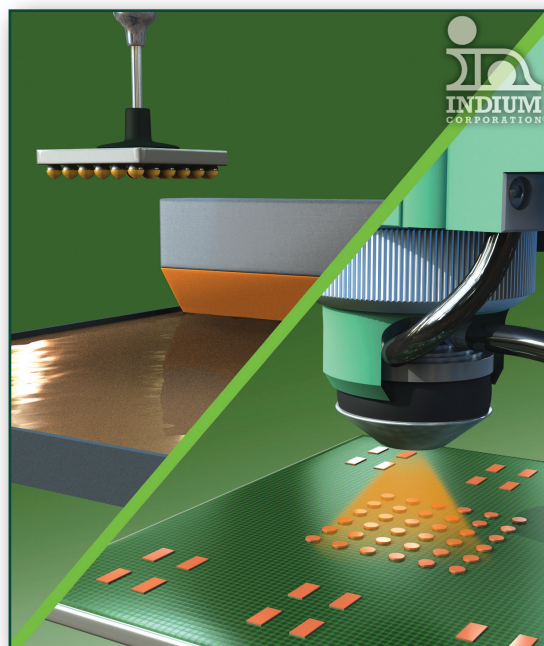
所有信息仅供参考。不作为产品的规格。

应用

倒装片助焊剂NC-826 在环氧树脂底部填充上的粘附力很强，特别是环氧树脂-胺基和环氧树脂-酸基的材料。倒装片助焊剂NC-826也适用于环氧树脂-酞基材料。

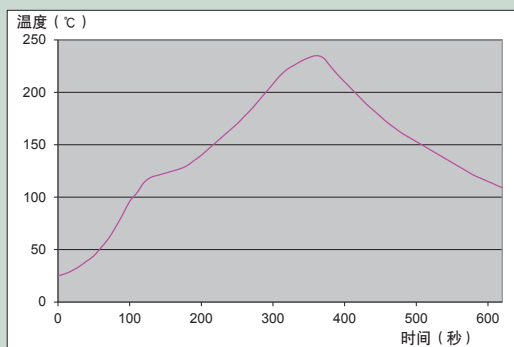
清洗

倒装片助焊剂 NC-826 是免洗助焊剂。如果必要，可以使用在市场上常见的助焊剂清洗剂去除。有关适合工艺需要的清洗剂的建议，请与Indium Corporation 的技术服务工程师联系。



回流

建议使用的温度曲线：



倒装片助焊剂 NC-826用于在含氧量为100ppm或更低的氮气氛围中进行回流。有些情况可以在空气中进行回流，然而在惰性气体中回流的效果最好。倒装片助焊剂 Flip-Chip Flux NC-826可以用在多种表面处理，其中包括浸金、铜、AuNi。这些表面可以用锡铅合金或者无铅合金焊接，但是，如果回流温度高于240℃，需要在氮气中进行。

接下页 →

www.indium.com

china@indium.com

亚洲：新加坡、韩国清州、马来西亚：+65 6268 8678

中国：苏州、深圳：+86 (0)512 628 34900

欧洲：Milton Keynes, Torino: +44 (0) 1908 580400

美国：Utica, Clinton, Chicago, Rome: +1 315 853 4900

Form No. 99075 (SC A4) R0



经
ISO 9001
注册

©2015 Indium Corporation

产品说明书

包装

倒装片助焊剂 **NC-826** 通常使用 **10cc** 和 **30cc** 注射器包装。为了满足特殊的要求，可提供其他包装。

储存

注射器包装和筒装的倒装片助焊剂 **NC-826** 在储存时，尖端应当朝下，储存温度为 **0°C** 至 **30°C** 时的保质期最长。如果是冷藏储存，倒装片助焊剂 **NC-826** 应当在温度上升到环境温度后再使用。

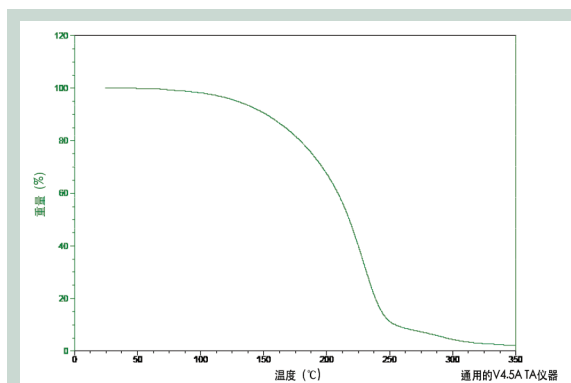
技术支持

Indium Corporation 树立了为全球客户迅速提供现场技术支持的业界标准。Indium 公司的技术支持工程师能够提供材料科学和半导体封装工艺应用领域的各方面专业知识。

安全数据资料

关于本产品的安全数据资料，请上网查阅，网址：
<http://www.indium.com/sds>

热重分析



TGA 是在升温速度为每秒 **10°C** 的情况下进行。

此产品说明书只提供一般性的参考信息，不能作为对所述产品性能的担保和保证。售出的产品以随产品所附的发票、出厂报告等书面保证及有关的限制条件为准。除非特别声明，Indium 公司的所有产品和解决方案都可以在市场上购买。

www.indium.com

china@indium.com

亚洲：新加坡、韩国清州、马来西亚：+65 6268 8678

中国：苏州、深圳：+86 (0)512 628 34900

欧洲：Milton Keynes, Torino：+44 (0) 1908 580400

美国：Utica, Clinton, Chicago, Rome：+1 315 853 4900



©2015 Indium Corporation

经
ISO 9001
注册